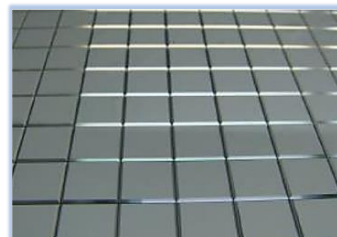


### 受託加工サービス内容

- Service1 裏面研削 (BG) +ポリッシュCMP : Siウエハ
- Service2 ダイシング : Siウエハ、膜付ガラス、セラミックス等
- Service3 トレイ詰め
- Service4 外観検査

### 裏面研削+ポリッシュCMP

フラットなウエハ以外も、はんだBUMP形成後のパターン面に凹凸のあるウエハにも100umt前後の薄残し研削が可能。  
量産では100umt、試作では100umt以下の薄仕上げにも対応。  
ご要望に合わせてBG研削による破砕層をポリッシュ加工でストレスリリース致します。



### ダイシング

1枚からお受けします。実験、試作、量産も対応可能です。  
加工実績 : Si、SiC、ガラス、FR-4等の樹脂、  
セラミック基板、Si on Glassの様な複合材、また経験の無い素材も試作致します。  
多角形の加工や、マルチパターン (シャトルチップ) の対応、  
お客様立会いテスト加工も可能です。



### トレイ詰め

ダイシング済みのチップをご指定のトレイ等へ移載して、良品のみのチップ梱包が可能。  
インチ対応のチップトレイ、JEDECトレイ、エンボステープへのウエハからの詰め替えや、  
カスタムサイズのトレイにも対応いたします。



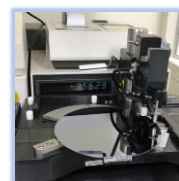
### 外観検査

お客様の仕様に併せて全数検査、抜き取り検査、ウエハ状態での検査等を致します。

実体顕微鏡、金属顕微鏡使用 検査倍率 : 15~200倍  
チップの抗折強度の評価・確認が可能です。(最大荷重100N)  
\*ニュートン、グラム、メガパスカルでのデータ出力が可能です。  
厚さ測定 (接触式) ウエハ状態からチップの厚さまで、測定可能です。

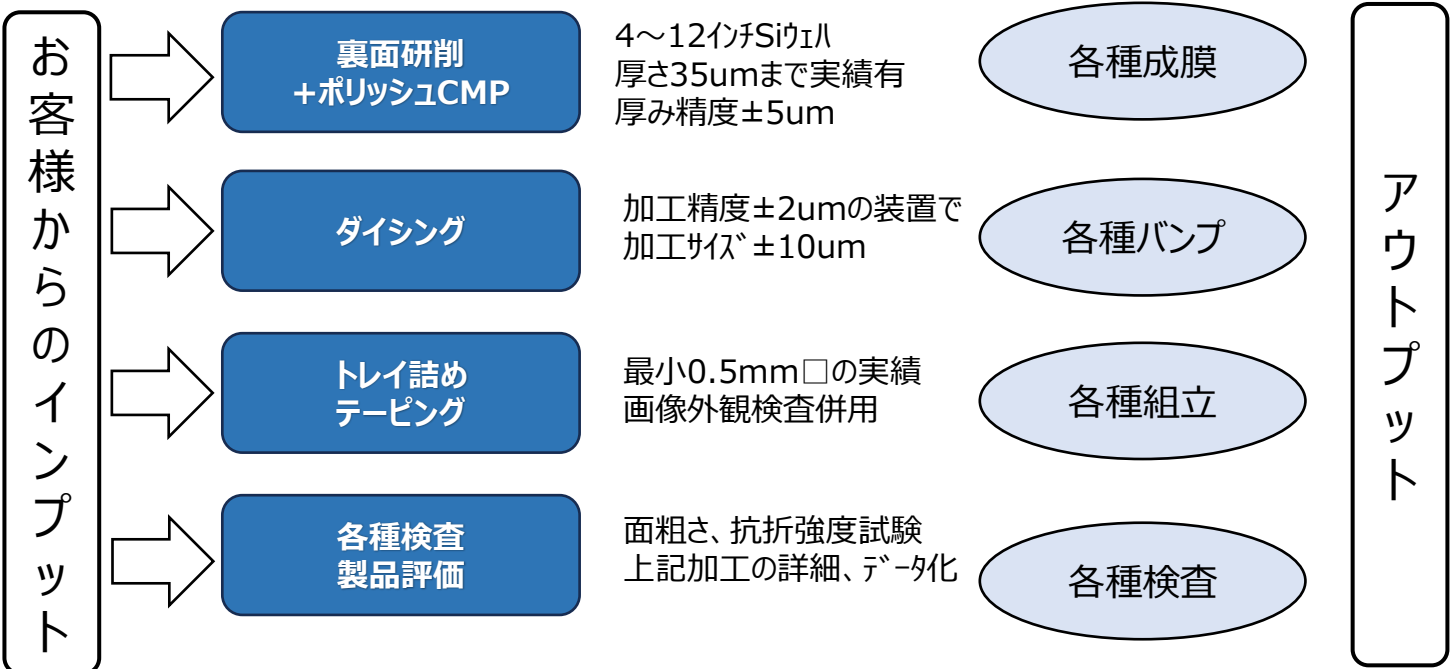
(0.001umまでの測定可能)  
チップの抗折強度の評価・確認が可能です。(最大荷重 100N)  
粗さ測定 (接触式) ウエハ裏面研削後の面粗さ状態の確認が可能です。  
(Ra≥0.001以上 測定が可能)

\* Ra、Rz、Ry、Rmax、Sm、S、tpなど出力パラメーターは全部で34種類。



お客様の「やりたいこと」を実現します！

どのようなご要望工程へも1枚から量産までのインプット可能です



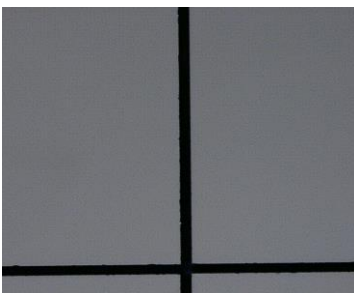
主なダイシング実績素材

Si、各種ガラス、FR-4等基板、セラミックス、  
ポリイミド基板、WLCSP、アクリル板等樹脂  
複合材（Si+ガラス等）

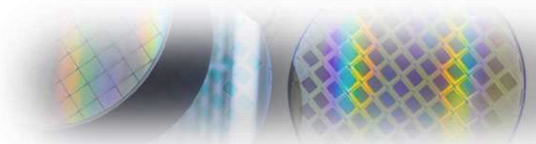
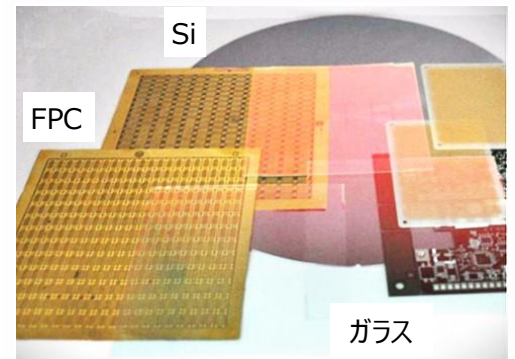
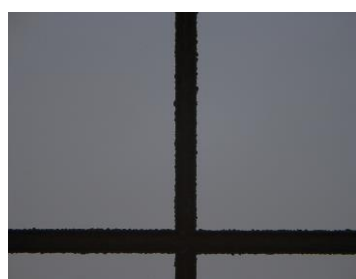
実績無しでも試作を行います

ダイシング加工例

SiC



サファイア



他にもこんな特徴があります！

- ✓ 半導体前工程のCMP受託加工サービスもございます
- ✓ 独自の加工レシピを所有
- ✓ BG・CMP・ダイシングの自社ワンストップサービス(東京青梅工場にて)